

株式会社東京精密 2025 年度(2026 年 3 月期) 第 2 四半期 決算説明会
質疑応答 要約

2025 年 11 月 4 日 開催

- 本資料は、上記日時に開催された 2025 年度(2026 年 3 月期)第 2 四半期決算説明会(Web 開催)の質疑応答の内容を、当社の判断で要約したものです。
- 本資料に記載されている情報は、決算説明会開催日時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。これらは、市況、競争状況、半導体業界ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、今後の当社の実際の業績が、本資料に記載されている情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。
- なお、本資料では、半導体製造装置(または同セグメント)を「SPE」、精密計測機器(同左)を「計測」と表記します。

1. 7-9 月期の SPE 受注高が会社想定を上振れた要因として、期ずれを想定していた HBM 向けの受注が貢献したのか。それ以外の要因はあるか。
 - 主因は、期ずれが見込まれていた HBM 関連受注を 7-9 月期中に獲得できたことである。また、NAND 向け案件も受注高の押し上げに貢献した。
2. 7-9 月期業績が公表予想対比でやや未達になった要因に台風の影響を挙げたが、その時期や、その影響が無かった場合の業績の認識について伺いたい。
 - 具体的には 9 月頃の台風による製品の輸送の遅れによるもの。この影響が無ければ、ほぼ公表予想並みの着地になったと分析している。
3. AI パッケージング向けグラインダの業況はどうか。
 - 順調に伸びている。
4. 生成 AI を含む HPC 関連受注高、売上高の実績、ならびに見込みを整理して説明いただきたい。
 - 以下のように要約する。

(SPE 受注高)

	2025 年度上期	2025 年度下期見込
生成 AI を含む HPC	前半期比 +24%	前半期比▲12%
うちロジック	前半期比 ▲11%	前半期比+28%
うち HBM	前半期比 +65%	前半期比▲37%

	2025 年度上期	2025 年度下期見込
SPE 受注高に占める HPC の割合	約 40%	30%半ば

(SPE 売上高)

	2025 年度上期	2025 年度下期見込
生成 AI を含む HPC	前半期比 +55%	前半期比 +66%
うちロジック	前半期比 +81%	前半期比 +4%
うち HBM	前半期比 +28%	前半期比 +158%

	2025 年度上期	2025 年度下期見込
SPE 売上高に占める HPC の割合	30%強	40%半ば

5. 決算資料や上記説明を踏まえると、2025 年度下期の HPC 受注見通しは以前から引きあがっているのか。また、HPC 以外の受注は、上期より減少する見通しなのか。そうであればその要因を知りたい。
- 下期の HPC 全般の受注見通しは以前より若干引き上がっている。
 - 一方、下期に向け、SiC や中国ローエンド需要は若干停滞すると想定。
6. 会社は 2025 年度通期業績予想を修正したが、売上高の修正(前回予想比+50 億円)に対して、営業利益の修正(同+5 億円)が軽微である背景を伺いたい。
- 利益予想策定の前提として、各種費用を計画通り織り込んでいることが一つ。
 - また、高付加価値製品の原価が当初想定以上に上昇している。5%低減を目標に、原価低減努力を続けている。
7. 会社は NAND むけ需要に改善傾向がみられるとコメントしたが、その背景は何か。事業機会と捉えている Hybrid Bonding 向けグラインダと関係があるか。
- 一部顧客でプローバの引合が強まっている。
 - 高性能な NAND は、テスト条件がタイトになり、測定時間が増加している。このため、プローバの需要が発生しているものと想定している。
 - したがって、Hybrid Bonding の議論とは連動していないし、全体的な NAND の市況回復とも捉えていない。
8. 2026 年度の SPE 事業見通しに関してコメントが欲しい。
- HBM4 向けの需要は、2026 年度にかけても期待を持っている。ASIC・汎用 DRAM 需要も同様だ。また中国ハイエンド需要やディスプレイドライバ IC 関連の需要にも期待している。
9. プローバの受注環境・生産納期・工場稼働状況などについてコメントが欲しい。
- プローバの受注は、高精度温度制御機能付きを中心に増加傾向にある。これらは

専用の部材・生産スペースを必要とするため、部材置き場の確保や専用設備の増強を必要としている。

- プローバの売上高は 5 年前の水準の 2 倍になっており、生産スペースの拡大は今後も必要だ。説明会でも述べた、飯能工場(埼玉県飯能市)の近接用地の取得計画についても、その視点にたったものである。
- 現在の生産納期は概ね 3・4 か月だが、製品仕様で大幅に異なるほか、足許では一括で受注を受け、異なる納期で出荷する案件もあり、このケースでは計画生産になるので、6 か月超の納期になる。
- なお、愛知県の名古屋工場(グライнда)は、すでに竣工し、生産稼働している。

10. 同業他社が、Die Prober の SAM(Serviceable Addressable Market)の拡大に期待しているとのコメントをしているが、会社の考えを伺いたい。

- 当社も開発を進めている。
- 現在 PLP 基板の大型化により、ダイサイズの大型化(100 mm角以上)も進んでゆくと考える。今後、大型ダイの検査用のプローバが必要になってくると考える。
- 現時点で、明確な想定は無いが、3・5 年内には具体化すると考えている。

11. 会社は 3D NAND の Hybrid Bonding の事業機会を従前より示しているが、現況を確認したい。

- 5 月、8 月の説明会で説明した内容と大きく変化は無い。現時点でも 2026 年度下期頃から、Hybrid Bonding 向けグライндаの量産向け出荷が始まるものと想定。

以上